



14. Bondexpo

Internationale Fachmesse für Klebtechnologie
International trade fair for bonding technology

 **05.-08. Oktober 2020**

 **Stuttgart**

smart solutions of bonding technology



Ausstellerinformation
Exhibitor-Information

 www.bondexpo-messe.de  [#bondexpo2020](https://twitter.com/bondexpo2020)    

Veranstalter:  P. E. SCHALL GmbH & Co. KG  +49 (0) 7025 9206-0  bondexpo@schall-messen.de

Bondexpo: Fügen und Verbinden in der modernen Montage

Die Bondexpo – Internationale Fachmesse für Klebtechnologie – zeigt Detail- und Systemlösungen zum Fügen und Verbinden von Komponenten und Baugruppen in der Vor- und Endmontage. Mit dem konsequenten Fokus auf die industrielle Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen erhalten Anwender aktuelle Praxisinfos hinsichtlich Materialien, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zuverlässigkeit sowie Fertigungseffizienz.

Der Themenbereich Digitalisierung ist inzwischen auch in der Fügetechnik von hoher Relevanz und daraus folgend auch die Veränderungen in der Klebtechnologie. Wenn es darum geht, verschiedene Werkstoffe unter Erhalt ihrer Eigenschaften langfristig miteinander zu kombinieren, ist die Klebtechnik unverzichtbar. Sie ist Zukunftstechnologie und Teil unzähliger industrieller Fertigungsprozesse und gilt in Industrie und Handwerk als Schlüsseltechnologie.

Komplementär, ganzheitlich, nutzerorientiert: Messeduo Motek/Bondexpo

Als weltweit einmaliges Messeduo treten Motek/Bondexpo bewährtermaßen gemeinsam an. Es ist gesetztes Branchenevent in Sachen Produktions- und Montageautomatisierung sowie Fügen und Verbinden. Der Fachbesucher erhält alles Erforderliche für die moderne, automatisierte Fertigung und den Weg zur Smart Factory an die Hand.

Fügen und Verbinden im Überblick: Spezial-Messeführer Fügetechnik

Im Spezial-Messeführer Fügetechnik sind alle Hersteller und Anbieter aufgeführt, die an der Motek und Bondexpo Komponenten, Baugruppen, Subsysteme, Komplettlösungen und Materialien zum mechanischen Fügen (Kleben, Druckfügen/Clinchen, Nieten, Verstemmen, Einpressen, Schrauben etc.) oder thermischen Fügen (Schweißen, Widerstands-/Punkt-Schweißen, Laserschweißen, Löten/Hartlöten etc.) offerieren. Hinzu kommen Zuführ- und Dosier- sowie Applikations-Einrichtungen, sodass der Anwender, in Verbindung mit den an der Motek präsentierten Handhabungs-/ Robotersystemen, sich umfassend über alle Bausteine zur rationalen Kleb-/Füge-/Verbindungstechnik informieren kann.



Bondexpo: Joining and Fastening in Modern Assembly

The Bondexpo international trade fair for bonding technologies will exhibit stand-alone and system solutions for joining and fastening components and modules in preassembly and final assembly. With its consistent focus on the industrial process sequence for joining/fastening by means of bonding, encapsulating, sealing and foaming, users receive up-to-date, practical information regarding materials, cost-effectiveness, quality, reliability and production efficiency.

In the meantime, the issue of digitalisation has become highly relevant in the field of joining technology, as well as for the resultant changes in bonding technology. Bonding technology is indispensable when it comes to combining different materials with long-term stability, while at the same time retaining their original properties. It's a future technology which is part and parcel to countless industrial manufacturing processes, and it's regarded as a key technology in industry and the commercial trades.

Complementary, Holistic, User-Oriented: Motek/Bondexpo Trade Fair Duo

Motek and Bondexpo join forces as a unique trade fair duo with proven effectiveness. It's a well-established industry event for automation in production and assembly, as well as for joining and fastening. Expert visitors are provided with everything they need for modern, automated production and the transition to the smart factory.

Joining and fastening at a glance: Special Trade Fair Guide for Joining Technology

The special trade fair guide for joining technology lists all of the manufacturers and distributors who offer components, modules, subsystems, complete solutions and materials for mechanical joining (bonding, clinching, riveting, caulking, press-fitting, screwing etc.) or thermal joining (welding, resistance/spot welding, laser welding, soldering and hard soldering etc.) at Motek and Bondexpo. This is supplemented by feeding and dosing as well as application equipment, so that the user, in combination with the handling/robot systems presented at Motek, can gather comprehensive information regarding all of the building blocks for streamlined bonding, joining and fastening technology.

14. Bondexpo - Die Leitmesse für Klebtechnologie

Mit der Bondexpo, internationale Fachmesse für Klebtechnologie, ist es innerhalb kurzer Zeit gelungen, den weltweiten Branchen- und Anwendertreff Nummer eins zu etablieren. Mit der klaren und konsequenten Ausrichtung auf die Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen werden für aktuelle und künftige Herausforderungen im Bereich des Fügens und Verbindens verschiedenster Materialien wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen offeriert.

Auf rund 3.000 Quadratmeter Fläche zeigen etwa 65 Aussteller Klebtechnik-Kompetenz, Dosiertechnik und Robotik – vom Material über Detaillösungen zum Komplettsystem. Klebtechnologien sowie in Kombination mit mechanischen oder auch thermischen Fügetechnologien angewandte Verbindungsverfahren zählen zu den elementaren Prozessen in der modernen Montage – vor allem beim Fügen von Leichtbaustrukturen. Moderne Klebtechnik- und Fügeverfahren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte und bietet der Industrie branchenübergreifend die Möglichkeit für die Erschließung neuer Märkte.

14th Bondexpo - Leading Trade Fair for Bonding Technology

The Bondexpo international trade fair for bonding technology has established itself as the number one meeting place for industry and users all over the world within a very short period of time. With its clear-cut, consistent alignment towards the joining/fastening process sequence by means of bonding, encapsulation, sealing and foaming, economical stand-alone and system solutions are offered for current and future challenges in the areas of materials joining and fastening.

Roughly 65 exhibitors will present bonding technology competence, dosing technology and robotics on approximately 3000 square metres of exhibition floor space – from materials and standalone solutions, right on up to complete systems. Bonding technologies, in combination with mechanical or thermal joining technologies and applied fastening techniques, are amongst the basic processes in modern assembly operations, above all for joining lightweight structures. Modern bonding technology and joining processes make a significant contribution to the development of new, innovative products and provide the industry sector with the opportunity of opening up new markets in all segments.

Konkrete Fachinformation vereint mit praktischer Nutzbarkeit

„Unsere Messen stehen für die industrielle Anwendbarkeit. Fachbesucher erhalten auf der Leitmesse für Klebtechnologie Bondexpo Informationen zum aktuellen Stand der wirtschaftlichen Füge- und Verbindungstechnik. Als bewährtes Messeduo Motek/Bondexpo gibt dieses weltweit einmalige Branchenevent Anwendern alles an die Hand, was in Sachen moderner Produktions- und Montageautomatisierung einschließlich Verbindungstechnik erforderlich ist“

Bettina Schall Geschäftsführerin, P. E. Schall GmbH & Co. KG

Concrete Technical Information United with Practical Usability

“Our trade fairs are targeted at industrial applicability. Expert visitors can gather information about the current status of economically efficient joining and fastening technologies at Bondexpo – the leading trade fair for bonding technology. As a tried and tested trade fair duo and a globally unique industry event, Motek/Bondexpo provides users with everything they need for modern production and assembly automation, including fastening technology.”

Bettina Schall Managing Director, P. E. Schall GmbH & Co. KG



International trade fair for bonding technology

Bondexpo Nomenklatur (Kurzübersicht)

- Rohstoffe für Kleb- und Dichtstoffe
- Maschinen, Anlagen und Zubehör für die Klebstoffherstellende Industrie
- Kleb- und Dichtstoffe
- Maschinen, Anlagen und Zubehör für die Klebstoffverarbeitende Industrie
- Dichtungs-, Prüf- und Messtechnik

Alle Ausstellereinformatoren kompakt

 www.bondexpo-messe.de/fuer-aussteller

Bondexpo Nomenclature (short survey)

- Raw materials for adhesives and sealants
- Machines, systems and accessories for the adhesives manufacturing industry
- Adhesives and sealants
- Machines, systems and accessories for the adhesives processing industry
- Sealing-, measuring and test technology

All exhibitor information in a compact format

 www.bondexpo-messe.com/for-exhibitors

39. Motek - Weltleitmesse für Produktions- und Montageautomatisierung

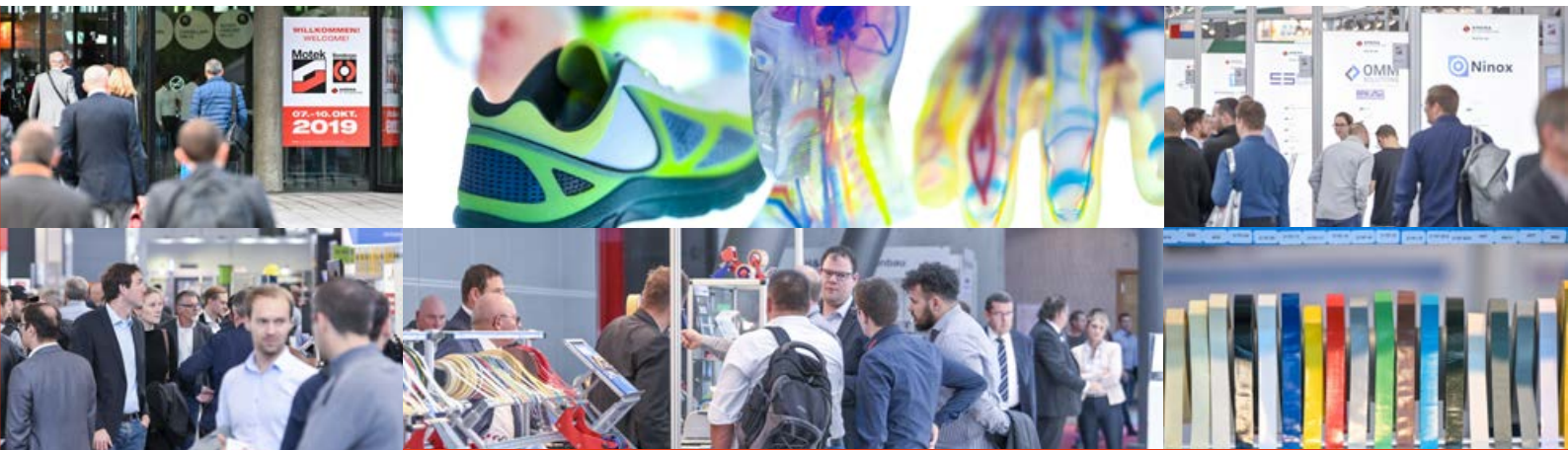
Die Motek – Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung – ist die Branchenveranstaltung zum Thema Produktions- und Montageautomatisierung. Fachbesucher erhalten weltweit auf keiner anderen Fachmesse einen solch umfassenden Überblick im Bereich der sich rasch verändernden Prozess-Automatisierung. Die Aussteller präsentieren Kunden und Anwendern aktuell nutzbare und zukunftssichere Lösungen für den industriellen Produktionseinsatz.

Kern des Produkt- und Leistungsportfolios der Motek sind topmoderne und nunmehr digitalisierte Komponenten, Baugruppen, Subsysteme und Komplettanlagen für die automatisierte Produktion und Montage. Für eine durchgängig automatisierte, stückzahlflexible Produktion aktuell und in der Zukunft zeigt diese Fachmesse an der industriellen Praxis ausgerichtete, in Technik und Kommunikation vernetzte Komplettlösungen. Fachbesucher können live erleben, wie die Digitalisierung die Produktions-, Handhabungs- und Montageprozesse effizienter gestaltet. Die Arena of Integration (AoI) zeigt eine praxisnahe Themen-Vernetzung und realitätsnahe Prozessabläufe, die nirgendwo sonst in dieser ganzheitlichen Form präsentiert werden.

39th Motek - World's Leading Trade Fair for Automation in Production and Assembly

The Motek international trade fair is the industry event for automation in production and assembly. No other trade fair in the world provides expert visitors with such a comprehensive overview of issues in the rapidly changing field of process automation. The exhibitors present customers and users with currently viable, future-proof solutions for industrial production applications.

Ultramodern and in the meantime digitalised components, modules, subsystems and complete machines for automated production and assembly are at the heart of Motek's portfolio of products and services. The trade fair will present complete solutions with networked technology and communication which are geared to actual industrial practice for consistently automated production with flexible lot quantities both now and in the future. Expert visitors can experience live how digitalisation makes production, handling and assembly processes more efficient. The Arena of Integration (AoI) presents highly practical networking of various topics and realistic process flows which can't be found anywhere else in such an all-embracing format.



Aussteller/Länder (inkl. Motek)

Exhibitors/Countries (incl. Motek)

976/32 davon **65/9** Bondexpo
thereof



Facts 2019

13. Bondexpo 13th Bondexpo



Auslandsvertretungen - Ein leistungsfähiges Netzwerk rund um den Globus
Foreign representatives - A powerful network around the globe



Belgien, Niederlande, Luxemburg
 Belgium, Netherlands, Luxembourg
 Sigrid Jahn
 InterMundio BV
 Netherlands
 +31 70 360 23 90
 info@intermundio.com

China (ausgenommen Taiwan)
 China (except Taiwan)
 Hermann Bohle
 Dragon Invest Co., Ltd. Shanghai P. R. China
 +86 21 62 15 56 68
 hermann.bohle@dragon-invest.com

Frankreich
 France
 Evelyne Gisselbrecht
 France
 +33 4 73 61 95 57
 info@tipise.com

Italien
 Italy
 Edgar Mäder
 Emtrad
 Italy
 +39 01 73 28 00 93
 info@emtrad.it

Korea
 Ben Huang
 THETW Co., Ltd.
 Taiwan
 +886-2 32 33 28 90
 ben_huang@thetw.com

Schweiz, Liechtenstein
 Switzerland, Liechtenstein
 Hermann Jordi
 Jordi Publipress GmbH
 Switzerland
 +41 3 26 66 30 90
 info@jordipublipress.ch

Taiwan
 Shever Hsiao
 THETW Co., Ltd.
 Taiwan
 +886-2 32 33 28 90
 shever_hsiao@thetw.com

Türkei
 Turkey
 Mehmet Ali Dincer
 RFL FAIR
 Turkey
 +90 21 24 52 03 64
 info@rflfair.com

United Kingdom, Irland
 United Kingdom, Ireland
 Steve Lindsey
 Lincoln West Ltd.
 United Kingdom
 +44 17 32 52 59 50
 steve@lincolnwest.co.uk



Besucher/Länder
 Visitors/Countries
35.165/77 (inkl. Motek)

Fläche brutto
 Area gross
3.000 m²/sqm

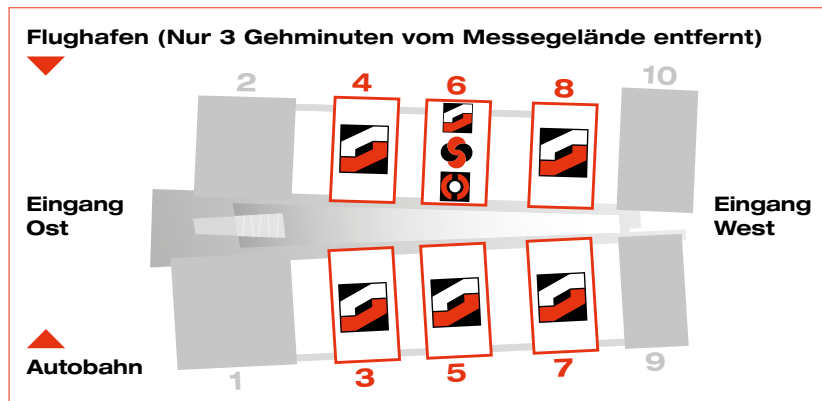
Zyklus: jährlich
 Cycle: every year



#bondexpo2020 #motek2020


Welcome to Bondexpo-Network    

Hallenübersicht



Projektleitung Projektmanager:

 Mike Döring

 +49 (0) 7025 9206-615

 doering@schall-messen.de



Zeitgleich findet statt Parallel event



39. Motek

Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung

International trade fair for automation in production and assembly

14. Bondexpo am High-Tech Standort Stuttgart - im Herzen Europas

Zentral und verkehrsgünstig liegt das Messegelände Stuttgart mitten in einer der stärksten und innovativsten Wirtschaftsregionen Europas. Nutzen Sie diese hervorragende Infrastruktur, um auf der Bondexpo 2020 Ihre Produkte gezielt dem Fachpublikum zu präsentieren.

Der Flughafen Stuttgart bietet täglich zahlreiche Direktflüge aus ganz Deutschland sowie aus ganz Europa.

14th Bondexpo at the High-Tech Venue in Stuttgart - at the Heart of Europe

With favourable travel connections, the trade fair grounds Stuttgart are centrally located at the middle of one of Europe's strongest and most innovative economic regions. Take advantage of this outstanding infrastructure in order to present your products to expert visitors in a targeted fashion at Bondexpo 2020.

Stuttgart International Airport offers numerous direct flights every day from locations all over Germany and throughout Europe.



Schall macht Messen für Märkte


#bestbusinesswithpleasure


Veranstalter:


P. E. Schall GmbH & Co. KG


 Gustav-Werner-Straße 6

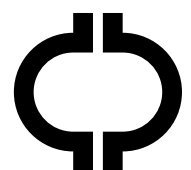
D - 72636 Frickenhausen

 +49 (0) 7025 9206-0

 +49 (0) 7025 9206-880

 bondexpo@schall-messen.de

 www.schall-messen.de



**SCHALL
MESSEN
FÜR MÄRKTE**